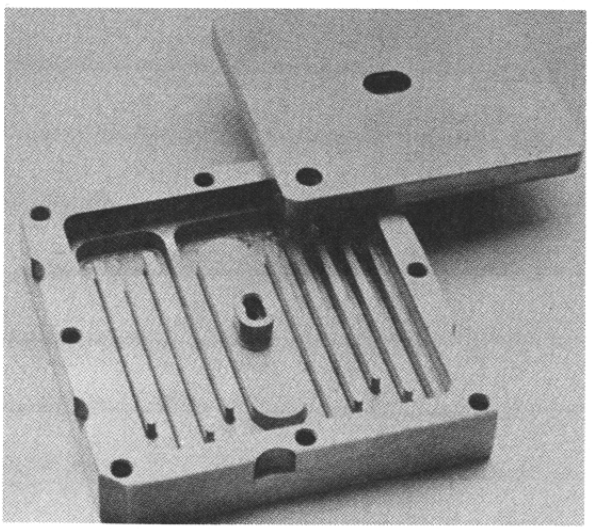
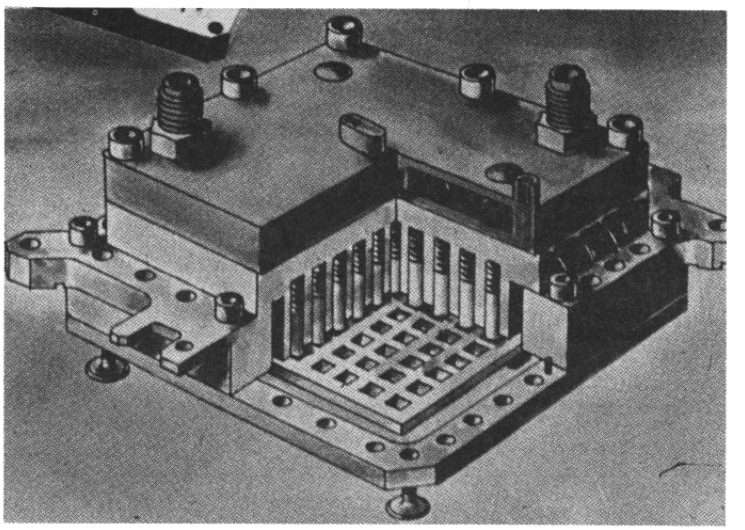
베릴륨 동의 사용례

BRUSHWELLMAN
ENGINEERED MATERIALS

AR 36-01-22

利用分野 : Computer 本体
使用素材 : 베릴륨 銅 Plate (厚板)





LSI의 高密度 設計에 의하여 電子製品의 小型化가 大幅的으로 促進 되었읍니다. 그러나 高密度 実装은 "熱"이라고 하는 바람직하지 못한 副産物을 隨伴하게 됩니다.

사진에 있는 熱伝導 module에는 piston이 chip와 module housing을 꽉 묶어서 熱이 베릴륨 銅의 heat sink에 伝達 되는 通路로 되어 있읍니다. 이 heat sink의 熱放散 效果가 chamber内를 循環하는 冷却水와 더불어 回路로 부터 熱을 뺏어서 system을 低温에 머물게 하는 役割을 하게 합니다.

〔製作技術上 材料에 要求되는 条件〕

(1) **熱伝導率이 높을 것.**
(2) **機械加工性이 아주 좋을 것.**
(3) **寸法의 安定性이 우수할 것.**
(4) **耐食性이 좋을 것.**

Module 本体의 上部에 놓이는 heat sink의 cover및 基板用 材料로 Brush Wellman社는 Alloy 3 HT plate를 供給합니다. 이 경우, 가장 重要한 것은 熱伝導率 인데 140 Btu/ft-hr-°F에 達합니다. 또 機械加工性도 基板에 후라이스盤으로 蛇紋状의 水路를 만들어야 하므로 重要합니다.

冷却水는 chamber 内를 恒時 循環하고 있어야 하므로 이 chamber는 耐食性도 좋아야 합니다.

더 자세한 사항은 하기처로 문의하여 주십시오.

製造 및 供給先
Brush Wellman Inc.
Alloy Division
17876 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44110 U. S. A.

韓國總 代理店
(株)도일코리아
서울 강남구 논현동 127-1 (국제빌딩 303호)
Tel. 514 - 3501 / 3
Fax. 514 - 3504